

トレックス・セミコンダクター株式会社  
品質保証部

## 成分表

製品名(鉛フリー): XC9223xxxxAR-G  
標準質量: 25 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	1.370	シリコン	54800	7440-21-3
		- 砒素	<1	7440-38-2
リードフレーム	10.091	銅	403600	7440-50-8
		錫	1000	7440-31-5
		亜鉛	900	7440-66-6
		クロム	1000	7440-47-3
		銀	22200	7440-22-4
ダイアタッチ	0.027	銀	1100	7440-22-4
		エポキシ	400	—
ボンディングワイヤ	0.371	金	14800	7440-57-5
封止樹脂	10.015	溶融シリカ	400600	60676-86-0
		エポキシ樹脂	29800	—
		フェノール樹脂	27500	—
端子メッキ	1.058	錫	42300	7440-31-5

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、  
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。